



素材にあわせて
3機種・3台が
短納期を実現します

1号機
オプンタイプ 1200×2400

2号機
テーブルタイプ 1200×2400

3号機
テーブルタイプ 1000×1000

長年の経験と技術がお役に立ちます!

ISO14001 認証取得

進化する「水の力の加工技術」

ウォータージェット加工センター

ウォータージェット応用加工・特殊加工

- 適合材 ● 複合素材 / 多層構造材 / 樹脂材 / 新素材 / 軟質材 / 硬質材 / 危弱材 / 焼入材
- 特 長 ● 熱影響がない / 切断のストレスがない / 素材機能にダメージを与えない



応用加工・特殊加工例

内筒外周ハブクリ及び溝加工
多層構造プリント基板加工
深穴・狭小溝のバリ除去加工
タイヤモントホール溝加工
エンボス加工
螺旋・変形溝加工
径5000個以下加工
ウォータージェット屋敷加工

株式会社 米山製作所

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原24-10

TEL 042-556-2358(代) FAX 042-556-2131(専)

<http://www.yoneyama.co.jp> ● info@yoneyama.co.jp(代)

特殊素材(ガラス・フィルムなどの)切断なら…		ダイシング加工	検索
サンテックのダイシング加工技術はお客様のニーズにお応えします。		削る ▶	磨く ▶
		切る ▶	詰める ▶ 見る
今年度試作ルーム完成！(BG・ダイシング・トレー誌・その他検査設備完備) 実験・評価・サンプル作成等でお困りのお客様にラインを貸出致します。 ※装置オペレーションは当社スタッフがお手伝いします。			
サンテックの加工技術紹介			
<input type="radio"/> 特殊素材への対応 ガラス・フィルムダイシング： 携帯電話やデジタルカメラに搭載するカメラモジュール用カバーガラスの切断	 はんだシートダイシング： 電子部品用チップの接合に使用される「はんだシート」などの軟素材の切断・トレー詰めまで対応		
<input type="radio"/> 次世代製品に対応した加工技術 <input type="checkbox"/> マルチチップウエハのダイシング加工 <input type="checkbox"/> 自社開発のBG加工技術は1チップからの加工、また個片ウエハの加工にも対応しています。	 <input type="checkbox"/> 水や異物、フラット基板に対応した保護テープを用いてダイシング。切断後に加熱することで、簡単に剥離。試作から小量産に対応。(平成21年度もづくり研究開発事業採択) 		
URL : http://www.c-suntec.co.jp/ 〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10 TEL042-557-7744(代) FAX042-557-7745		 株式会社 サンテック ISO9001、14001 認証取得	

Cufitec
キュフィテック
高性能マスク